

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2025-028

转债代码：113616

转债简称：韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司

关于 2025 年度为控股子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：北京京鸿志科技有限公司（以下简称“北京京鸿志”）、香港华清电子（集团）有限公司（以下简称“香港华清”）、上海豪威集成电路集团有限公司（以下简称“上海豪威”）。

● 本次担保金额及实际已为其提供的担保余额：预计 2025 年度上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“韦尔股份”）为控股子公司的银行及其它金融机构信贷业务以及日常经营业务提供担保，担保额度合计不超过等值人民币 33 亿元人民币及外币融资；截至本公告披露日，公司为前述被担保人担保余额约为人民币 0.88 亿元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：公司控股子公司上海豪威资产负债率超过 70%，请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保情况及已履行的决策程序

2025 年 4 月 15 日，公司召开第六届董事会第四十三次会议、第六届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度为控股子公司提供担保额度的议案》，确定公司为控股子公司的银行及其它金融机构信贷业务以及日常经营业务提供担保，担保额度合计不超过等值人民币 33 亿元人民币及外币融资，提

请公司股东大会授权公司董事长、总经理或财务总监在上述额度范围内具体执行。在公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，公司为控股子公司在上述担保总额度内签订的担保合同均为有效。该事项尚需提交至公司股东大会审议。

(二) 本次担保预计基本情况

公司为控股子公司提供的具体担保额度预计如下：

被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(亿元)	本次新增担保额度(亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	
1、资产负债率为 70%以上的控股子公司							
上海豪威	韦尔股份 100%	71.59%	0.88	19.00	7.84%	2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内	
2、资产负债率为 70%以下的控股子公司							
北京京鸿志	韦尔股份 100%	21.52%	/	10.00	4.13%		
香港华清	韦尔股份 100%	55.54%	/	4.00	1.65%		
合计				33.00	13.62%		

上述担保方均为公司，且不存在关联担保及反担保情形

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人基本情况

1、北京京鸿志

公司名称	北京京鸿志科技有限公司	成立时间	2001-09-10
注册资本	43,000.00 万元人民币	法定代表人	张沛丰
统一社会信用代码	911101086003836827		
注册地址	北京市北京经济技术开发区荣华中路 22 号院 3 号楼 8 层 802-2		
经营范围	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电、文化用品、家用电器；租赁机械设备（不含汽车租赁）		
总资产	90,693.43 万元	负债合计	19,520.36 万元
		净资产	71,173.07 万元
营业收入	145,958.08 万元	净利润	6,173.26 万元

2、香港华清

公司名称	香港华清电子（集团）有限公司	成立时间	2018-12-03
注册资本	10,000.00 万元港币		
注册地址	FLAT/RM 917B, BLOCK A, 9/F, NEW MANDARIN PLAZA, NO.14 SCIENCE MUSEUM ROAD, TSIMSHATSUI, KLN, HONG KONG		
经营范围	国际贸易		
总资产	121,604.84 万元	负债合计	67,540.37 万元
		净资产	54,064.47 万元
营业收入	370,295.46 万元	净利润	5,385.90 万元

3、上海豪威

公司名称	上海豪威集成电路集团有限公司	成立时间	2021-07-02
注册资本	50,000.00 万元人民币	法定代表人	王崧
统一社会信用代码	91310000MA1H3X5962		
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼		
经营范围	集成电路设计；集成电路销售；从事集成电路领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
总资产	103,570.56 万元	负债合计	74,141.78 万元
		净资产	29,428.78 万元
营业收入	200,669.36 万元	净利润	-1,894.64 万元

(二) 上述被担保人均为公司控股子公司，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：由公司和/或公司控股子公司以连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等法律法规允许的担保方式为被担保人提供担保。

2、担保金额：为控股子公司的银行及其它金融机构信贷业务以及日常经营业务提供担保，担保额度合计不超过等值人民币 33 亿元人民币及外币融资。

3、上述担保额度安排是基于对目前业务情况的预计，在年度担保计划范围内，控股子公司的担保额度可调剂给其他控股子公司使用（资产负债率为 70% 以上的控股子公司除外）。

4、在股东大会批准上述担保事项的前提下，董事会提请股东大会授权董事

长、总经理或财务总监审批在额度之内的具体的担保事宜并签署相关法律文件。

5、在超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

6、在公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，本公司和/或公司控股子公司为上述被担保人在以上担保的总额度内，签订的担保合同均为有效。

上述预计担保总额仅为公司 2025 年度拟提供的担保额度，尚需银行或相关机关审核同意，具体担保金额以实际签署的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

(一) 本次预计的担保额度是基于公司及控股子公司的经营发展需要确定的，增加预计担保额度有利于满足现阶段业务需求，有助于公司及控股子公司业务的正常开展，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，符合公司整体利益。

(二) 本次预计担保的被担保方均为公司控股子公司，根据公司目前项目的经营情况和未来发展计划，公司控股子公司经营状况稳定，各控股子公司有能力偿还各自借款，并解除相应担保，担保风险在可控范围内，不存在影响其偿债能力的重大事项。

五、董事会意见

公司 2025 年度为控股子公司提供担保额度的事项已经公司第六届董事会第四十三次会议全票审议通过，该事项尚需提交至公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对前述控股子公司提供的担保金额约为 1.01 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.42%；公司无逾期担保的情况。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日